

<<多芯片组件技术手册>>

图书基本信息

书名：<<多芯片组件技术手册>>

13位ISBN编号：9787121022807

10位ISBN编号：712102280X

出版时间：2006-2

出版时间：电子工业出版社

作者：盖瑞

页数：527

字数：877

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<多芯片组件技术手册>>

内容概要

多芯片组件（MCM）技术是当代先进的微电子组装与封装技术。

本书从电路设计、材料性能、工艺装配、封装热设计和测试等方面综合论述了多芯片组件技术及其最新进展情况；并对其技术特性和应用领域进行了深入的研究，包括多芯片组件所涉及的相关领域，如微电子学、物理学、化学和物理化学等交叉学科的详细信息。

本书可以作为国内从事混合微电子专业的技术人员的参考书，也可以作为高等院校电子学和微电子相关专业的本科生和研究生的教科书。

<<多芯片组件技术手册>>

作者简介

Philip E.Garrou, 目前是陶氏化学公司微电子专业首席科学家。

他在该公司工作23年, 一直从事微电子技术很多领域的研究工作, 包括微电子封装应用的AlN电子陶瓷和聚合物。

Garrou博士是MMS/陶氏化学公司大面积工艺线的计划、大面积工艺的DARPA同盟和DARPA无缝高级脱片连通(S

<<多芯片组件技术手册>>

书籍目录

第1章 技术推动力 1.1 引言 1.2 系统封装的挑战 1.3 封装效率 1.4 小型化 1.5 可靠性 1.6 未来的挑战 参考文献第2章 MCM-C材料、工艺及应用 2.1 引言 2.2 厚膜混合集成电路 2.3 高温共烧氧化铝(HTCC) 2.4 低温共烧陶瓷(LTCC)基板 2.5 氮化铝 2.6 典型MCM制造商设计规范 2.7 MCM-C应用实例 2.8 陶瓷MCM的未来方向 参考文献第3章 MCM D薄膜材料、工艺和应用 3.1 引言 3.2 结构材料 3.3 薄膜加工 3.4 薄膜MCM工艺 3.5 可靠性 3.6 应用范围 参考文献第4章 MCM.L材料、工艺和应用第5章 高密度、大面积工艺(LAP)第6章 3D封装第7章 MCM封装设计第8章 组装第9章 组件与电路板的连接第10章 多芯片组件设计第11章 MCM电性能分析第12章 高性能数字集成电路电子封装第13章 热管理第14章 已知好芯片(KGD)第15章 MCM测试和可测试性设计

<<多芯片组件技术手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>